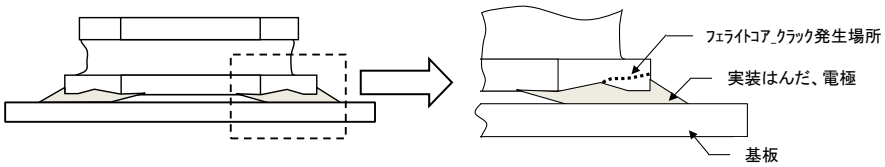
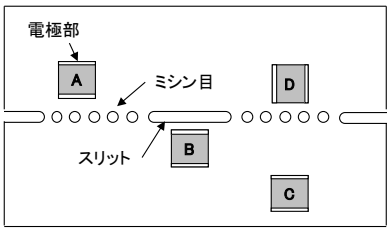
車載パワートレイン/セーフティ用（AEC-Q200 Qualified）巻線フェライト系パワーインダクタ LAYP シリーズ
車載パワートレイン/セーフティ用（AEC-Q200 Qualified）巻線フェライト系パワーインダクタ LAXH シリーズ
車載ボディ/インフォ＆高信頼用（AEC-Q200 Qualified）巻線フェライト系パワーインダクタ LCXN/LCXP シリーズ
車載ボディ/インフォ＆高信頼用（AEC-Q200 Qualified）巻線フェライト系パワーインダクタ LCXH シリーズ
車載ボディ/インフォ＆高信頼用（AEC-Q200 Qualified）巻線フェライト系 D 級アンプ用インダクタ LCXA
車載ボディ/インフォ＆高信頼用（AEC-Q200 Qualified）巻線フェライト系パワーインダクタ LCRN シリーズ

■使用上の注意

1. 回路設計	
注意点	◆使用環境及び定格・性能の確認 1. 医療機器、宇宙用機器あるいは原子力関係機器などは、故障が発生した場合、人命への影響または社会的に甚大な損失を与えます。これらの機器に使用するインダクタは、汎用インダクタと区別した高い信頼性設計が必要になる場合があります。 2. 結露状態となる場所、腐食性ガス（硫化水素、亜硫酸、塩素、等）が充満する場所で使用すると、特性劣化に至る場合があります。このような環境での使用は避けて下さい。 ◆使用電流（定格電流の確認） 1. インダクタに通電される電流は、突入電流も含めて定格電流以下で使用して下さい。また、直流電流に交流電流が重畳されている電流の場合は、尖頭電流の和が定格電流以下となるようにして下さい。 2. 磁気飽和によってインダクタンスが低下するため、許容電流以上の電流は通電しないで下さい。 ◆温度上昇 パワーチョークコイルの温度上昇は最終製品の設置条件によって決まります。 実際の最終製品で、パワーチョークコイルの温度上昇が指定された温度範囲内に収まることを確認して下さい。

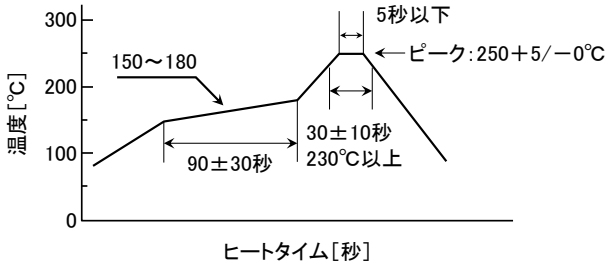
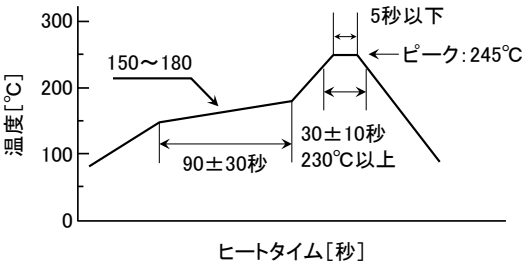
2. 基板設計	
注意点	◆取り付け箇所の設計 1. ランドパターンについては、推奨ランドパターンをご参照下さい。 2. 基板のひずみによる製品へのストレスがあります。 （LAXH/LCXN/LCXP/LBXN/LBXP/LMXN/LMXP, LCXH/LCXA/LBXH/LMXH） 3. 基板への部品配置について配慮願います。 （LAXH/LCXN/LCXP/LBXN/LBXP/LMXN/LMXP, LCXH/LCXA/LBXH/LMXH）
管理ポイント	◆取り付け箇所の設計 実装上の注意 1. 実装状態を確認の上ご使用下さいますようお願いいたします。 2. 本製品のはんだ付けはリフローはんだ工法に限ります。 3. 推奨ランドパターンは、電気特性、実装性を考慮しています。この寸法以外で設計されますと位置ずれ等によるはんだ付け不具合、製品へのストレスが掛かることがあり、十分な性能を得られない場合があります。推奨ランドパターンと異なる場合、はんだ付け後の製品へのストレスが大きくなり、製品クラックや特性不具合の原因になる場合があります。ご採用の検討時におかれましては十分に評価を行い、貴社責任下においてご使用可否の判断をお願いいたします。 （LAXH/LCXN/LCXP/LBXN/LBXP/LMXN/LMXP, LCXH/LCXA/LBXH/LMXH） 4. 実装後に熱ストレスを与えた場合、実装する基板と製品の熱膨張係数の違いから、フェライトコアへクラックが発生する場合があります。（下記図参照）ご採用の検討時おかれましては十分に評価を行い、貴社責任下においてご使用可否の判断をお願いいたします。 （LAXH/LCXN/LCXP/LBXN/LBXP/LMXN/LMXP, LCXH/LCXA/LBXH/LMXH）  5. 基板のそり・たわみに対して、ストレスが加わらないよう製品の位置、方向を配慮願います。基板を分割する際、分断付近では製品へ

	のストレスを受けやすくなりますので配慮願います。 （LAXH/LCXN/LCXP/LBXN/LBXP/LMXN/LMXP, LCXH/LCXA/LBXH/LMXH）  A>C>B≡D の順でストレスを受けやすくなります。 ストレスが加わらない様に部品の配置を配慮願います。

3. 実装

注意点	◆実装状態 1. 製品を基板に実装する場合には、製品本体に過度の加重が加わらない様にして下さい。 2. 実装状態を御確認の上御使用下さいます様お願い致します。
管理ポイント	◆実装状態 1. 実装時、製品に過度の加重が加わりますと破損する場合があります。 2. 実装後の基板の取り扱い時には、たわみやひねりにおいても製品にストレスが加わることがありますので、ご採用の検討時おかれましては十分に評価を行い、貴社責任下においてご使用可否の判断をお願いいたします。 （LAXH/LCXN/LCXP/LBXN/LBXP/LMXN/LMXP, LCXH/LCXA/LBXH/LMXH） ＜たわみ＞ ＜ひねり＞

4. はんだ付け

注意点	◆リフローはんだ付け 1. リフローはんだ付けは弊社営業窓口にご相談頂き、納入仕様書の推奨条件に従って行って下さい。 2. 本製品のはんだ付けはリフローはんだ付け工法に限ります。 3. リフロー後常温に戻るまでは、製品に応力が加わらない様にして下さい。 ◆鉛フリーはんだによるはんだ付け 1. 本製品をご使用時、鉛フリーはんだをご使用される場合は固着強度、はんだ耐熱温度、はんだ付け性、はんだフィレット形成状態等を十分にご確認いただき、ご使用されるようお願い致します。 ◆はんだゴテによる修正作業 1. はんだゴテによる修正作業はランド部にコテ先をあて、コテ先温度 350℃以下、3 秒以内で行って下さい。コテ先は、製品に直接触れないようにして下さい。
管理ポイント	◆リフローはんだ付け 1. 規定のはんだ条件の範囲を超えると過度の熱により製品が破損する場合があります。 推奨リフロー温度プロファイル（鉛フリーはんだ使用時のみ適用） LAXH/LCXN/LCXP/LBXN/LBXP/LMXN/LMXP, LCXH/LCXA/LBXH/LMXH, LCRN/LBRN/LMRN  LAYP 

5. 洗浄

注意点	◆基板洗浄

▸ 当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、弊社製品をご検討頂く際には、納入仕様書にて詳細な仕様の確認をお願いします。
また、各商品の詳細情報（特性グラフ、信頼性情報、使用上の注意事項など）につきましては、当社 Web サイト（http://www.ty-top.com/）に掲載しております。

	超音波による洗浄はご容赦願います。
管理ポイント	◆基板洗浄 1. 超音波洗浄を行うと超音波洗浄力により製品が破損する場合があります。

6. 取り扱い	
注意点	◆一般的な取り扱い 1. 磁石及び磁気を帯びたものを近づけないで下さい。 ◆基板分割 1. 部品実装後、基板分割作業の際には、基板にたわみやひねりストレスを与えないように注意して下さい。 2. 基板分割時は、手割りを避け専用治具などで行って下さい。 ◆機械的衝撃 1. 落下及び衝突などによる過度の機械的衝撃を与えないで下さい。 2. 運搬時には製品に物が接触して製品に衝撃及び力が加わらないようにして下さい。 ◆製品への押下 1. 巻線部分に力が加わる様な押下をしないで下さい。フェライトコア露出部に衝撃及び押下をしないで下さい。 ◆梱包状態での取り扱い 1. 梱包箱の積み重ねは、極力避けて下さい。
管理ポイント	◆一般的な取り扱い 1. 磁気の影響により特性が変化する場合があります。 ◆基板分割 1. 基板を分割する際にたわみやひねりなどのストレスを与えますと製品が破損する場合がありますので、極力ストレスを与えないようにして下さい。 ◆機械的衝撃 1. 機械的衝撃により破損する場合があります。 2. 運搬時の取り扱いにより破損する場合があります。 ◆製品への押下 1. 過度の衝撃、応力により破損および特性が変化する場合があります。 ◆梱包状態での取り扱い 1. 梱包箱の積み重ねにより、テープの変形や製品が破損する場合があります。

7. 貯蔵・保管	
注意点	◆貯蔵・保管 1. 梱包材の劣化や電極のはんだ付け性を損なわないため、温度－5～40℃、湿度 70%以下で保管できますが、周囲温度 30℃以下を推奨致します。また良好な条件下での保管でも時間とともにはんだ付け性は劣化しますので、弊社出荷より 6 ヶ月以内にご使用下さいます様お願い致します。尚、6 ヶ月を越えた場合は、はんだ付け性をご確認の上ご使用をお願い致します。
管理ポイント	◆貯蔵・保管 1. 高温高湿環境下では、電極端子の酸化によるはんだ付け性の劣化やテーピングなどの性能劣化が加速される場合があります。